

# 合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-020

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	瑞银资管、东北证券、国联电子、安信证券、华安证券、华鑫证券
时间	2024年7月8日-2024年7月9日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 问：客户的订单是全制程吗？</b> 答：目前基本上是 Turn-key 全制程的订单，只有少部分业务根据客户需求和公司实际产能情况进行调整，仅包括“凸块制造”或“凸块制造与晶圆测试服务”等单项或非全制程组合服务。</p> <p><b>2. 问：公司为什么会开始非显示类芯片封测业务？</b> 答：依托在显示驱动芯片封测领域多年来的耕耘以及对凸块制造技术的积累，公司于2015年将业务拓展至非显示类芯片封测市场，目前该领域已日渐成为公司业务重要的组成部分以及未来重点发展的板块。公司现可为客户提供包括铜柱凸块（Cu Pillar）、铜镍金凸块（CuNiAu Bumping）、锡凸块（Sn Bumping）在内的多种高端金属凸块制造，也可同时提供后段的 DPS 封装服务。</p> <p><b>3. 问：公司晶圆来源的情况？</b> 答：公司晶圆来源超过半数来自境内晶圆厂，如 SMIC、晶合集成、粤芯、华虹等，其他则由境外晶圆厂提供，如台积电、力积电、世界先进、UMC 等。</p> <p><b>4. 问：公司目前订单能见度？</b> 答：目前公司客户一般约提供 3 个月的需求预测。</p> <p><b>5. 问：合肥厂未来的规划及产能？</b> 答：结合合肥上游晶圆厂和下游面板厂的产业链完整度等情</p>

	<p>况，合肥厂预计以显示业务为主，负责 12 吋晶圆的封装测试，首阶段产能规划为 BP 与 CP 各约 1 万片/月产能，COF 约 3,000 万颗/月产能，COG 约 3,000 万颗/月产能。</p> <p><b>6. 问：什么是 DPS？</b></p> <p>答：DPS 作为 Fan-in WLCSP 中的重要环节，指将经测试后的晶圆研磨切割成单个芯片，并准确放置在特制编带中。公司具备钻石硬刀切割、激光开槽、激光切割等制程能力，切割后的芯片封装尺寸可从最小 0.2mm 到最大 6mm，同时可对芯片进行 6 个面的红外光透视检查。此外，公司拥有砷化镓、氮化镓、钽酸锂等新一代半导体材料的 DPS 能力。配合铜柱凸块、锡凸块，可用于电源管理芯片、射频前端芯片等芯片的 Fan-in WLCSP 制程</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 9 日